第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当社グループ（当社及び連結子会社）では、新製品の研究開発、サービス提供能力の拡大、生産の効率化、品質の向上等を図るべく、設備の拡充・改良並びに更新を進めており、当連結会計年度におきましては、厳しい経営環境を勘案して、減価償却費の範囲内で成長分野に集中し、1,476億円の設備投資を行いました。

その主要なものといたしましては、ソフトウェア・サービス関係では、ブロードバンドＩＤＣ事業の強化を図るため、アウトソーシング設備及びネットワーク基盤設備を増強し、388億円を投資いたしました。

プラットフォーム関係では、ＵＮＩＸサーバ、グローバルサーバ等の基幹システム製品及びＬｉｎｕｘサーバ等の開発設備のほか、ＩＰシステム、モバイルシステム等の開発・検証設備の増強を行い、367億円を投資いたしました。

電子デバイス関係では、最先端ロジックＩＣ量産設備の構築を行い、609億円を投資いたしました。

なお、設備投資額につきましては、上記セグメント以外の設備投資額並びに当社の一般管理部門及び共通部門等の各セグメントに配賦できない設備投資額111億円が含まれております。

２【主要な設備の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、以下のとおりであります。

(1) ソフトウェア・サービス

平成15年３月31日現在

会社名及び事業所名（所在地）		設備の内容	投下資本（百万円）					従業員数（人）
			土地（面積千㎡）	建物及び構築物	機械装置	その他	合計	
提出会社	幕張システムラボラトリ（千葉市美浜区）	システム開発設備	3,708 (14)	13,013	45	1,410	18,177	1,198
	情報処理システムラボラトリ（東京都大田区）	システム開発設備	1,110 (24)	2,520	3,461	1,879	8,971	979
	館林システムセンタ（群馬県館林市）	アウトソーシング設備	1,913 (126)	8,706	1,014	6,227	17,862	188
	関西システムラボラトリ（大阪市中央区）	システム開発設備	9,263 (13)	3,822	64	396	13,546	724
在外子会社	Fujitsu Services Holdings PLC（イギリス他）（注４．）	システム開発設備及びアウトソーシング設備	0 (0)	6,334	3,056	17,757	27,147	13,108

(2) プラットフォーム

平成15年３月31日現在

会社名及び事業所名（所在地）		設備の内容	投下資本（百万円）					従業員数（人）
			土地（面積千m²）	建物及び構築物	機械装置	その他	合計	
提出会社	長野工場（長野県長野市）	磁気ディスク装置製造設備	920 (105)	8,487	6,272	1,601	17,281	478
	小山工場（栃木県小山市）	光伝送システム製造設備	981 (184)	6,577	2,473	3,769	13,801	1,002
	那須工場（栃木県大田原市）	移動通信システム製造設備	1,250 (184)	3,686	1,258	6,155	12,351	654
国内子会社	㈱富士通ITプロダクツ本社（石川県河北郡宇ノ気町）	コンピュータ製造設備	388 (173)	2,933	796	925	5,044	503
在外子会社	Fujitsu IT Holdings, Inc.（米国他）（注５．）	情報処理システム開発設備	286 (11)	3,268	3,602	1,616	8,772	9,140
	Fujitsu Network Communications, Inc. リチャードソン工場（米国テキサス州）	光伝送システム製造設備	3,727 (760)	8,878	809	5,974	19,388	1,548
	Fujitsu Computer Products Corporation of the Philippines カーメルレイ工場（フィリピン）	磁気ディスク装置製造設備	0 (283)	2,913	10,420	145	13,478	6,156

(3) 電子デバイス

平成15年３月31日現在

会社名及び事業所名（所在地）		設備の内容	投下資本（百万円）					従業員数（人）
			土地（面積千m²）	建物及び構築物	機械装置	その他	合計	
提出会社	三重工場（三重県桑名郡多度町）	半導体製造設備	4,327 (307)	12,365	7,947	1,777	26,418	1,026
	岩手工場（岩手県胆沢郡金ヶ崎町）	半導体製造設備	2,881 (290)	10,635	17,043	3,893	34,453	1,827
	会津若松工場（福島県会津若松市）	半導体製造設備	3,432 (369)	6,855	5,980	1,583	17,853	1,464
	あきる野テクノロジセンター（東京都あきる野市）	半導体研究開発、製造設備	12,756 (121)	15,757	2,499	2,622	33,675	2,207
国内子会社	富士通エイ・エム・ディ・セミコンダクタ㈱（福島県会津若松市）	フラッシュメモリ製造設備	0 (181)	23,349	62,512	1,703	87,565	1,557
	新光電気工業㈱ 高丘工場（長野県中野市）	半導体パッケージ製造設備	2,109 (97)	5,487	5,295	3,533	16,426	1,192

平成15年３月31日現在

会社名及び事業所名(所在地)		設備の内容	投下資本（百万円）					従業員数(人)
			土地(面積千㎡)	建物及び構築物	機械装置	その他	合計	
国内子会社	富士通日立プラズマディスプレイ㈱（宮崎県東諸県郡国富町）	プラズマディスプレイパネル製造設備	1,048 (221)	5,845	3,749	127	10,772	727
	富士通カンタムデバイス㈱本社（山梨県中巨摩郡昭和町）	化合物半導体製造設備	933 (107)	5,331	1,355	741	8,784	859

(4) 共通

平成15年３月31日現在

会社名及び事業所名(所在地)		設備の内容	投下資本（百万円）					従業員数(人)
			土地(面積千㎡)	建物及び構築物	機械装置	その他	合計	
提出会社	川崎工場（川崎市中原区）	ソフトウェア、情報処理システム及び通信システムに関する研究開発設備	3,886 (175)	17,090	1,501	13,820	36,298	8,619
国内子会社	㈱富士通研究所厚木研究所（神奈川県厚木市）	ソフトウェア、情報処理システム、通信システム及び電子デバイスに関する研究開発設備	0 (19)	4,153	3,614	2,316	10,083	566

（注）１．投下資本は期末帳簿価額によります。ただし、建設仮勘定を除きます。
２．投下資本の機械装置には、車両及び運搬具を含みます。また、その他とは工具器具及び備品であります。
３．Fujitsu Services Holdings PLC及びFujitsu IT Holdings,Inc.の数値は、各社の連結決算数値であります。
４．建物の一部を賃借しており、年間賃借料は6,548百万円であります。
５．ソフトウェア・サービス事業を一部含んでおります。また、建物の一部を賃借しており、年間賃借料は3,038百万円であります。
６．富士通エイ・エム・ディ・セミコンダクタ㈱及び㈱富士通研究所の土地はすべて当社から賃借しているものであります。
７．Fujitsu Computer Products Corporation of the Philippinesの土地はすべてFujitsu Development Corporation of the Philippinesから賃借しているものであります。
８．上記のほか、主要なリース資産として以下のものがあります。

会社名及び事業所名(所在地)		設備の内容	未経過リース料（百万円）
提出会社	あきる野テクノロジセンター（東京都あきる野市）	最先端半導体開発設備	12,676
国内子会社	富士通日立プラズマディスプレイ㈱宮崎営業所（宮崎県東諸県郡国富町）	プラズマディスプレイパネル製造設備	14,914
	富士通カンタムデバイス㈱本社（山梨県中巨摩郡昭和町）	化合物半導体製造設備	7,402

３【設備の新設、除却等の計画】

(1) 当社グループ（当社及び連結子会社）の当連結会計年度後１年間の設備投資計画（新設・拡充）は、210,000百万円であり、事業の種類別セグメントごとの内訳は次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称	平成15年３月末計画額（百万円）	設備等の主な内容・目的
ソフトウェア・サービス	80,000	アウトソーシング関連設備、ネットワークサービス設備の更新及び拡充、新拠点の建設
プラットフォーム	50,000	モバイルシステム関連設備、ＩＰシステム関連設備、ＵＮＩＸ及びＬｉｎｕｘ開発・検証設備の更新及び拡充
電子デバイス	65,000	最先端ロジックＩＣ開発・量産設備、プラズマディスプレイパネル製造設備
金融、その他、全社共通	15,000	オーディオ・ビジュアル・通信機器、自動車用電子機器の開発・製造設備
計	210,000	―

（注）１．今後の所要資金210,000百万円は、自己資金により充当する予定であります。
３．設備投資の計画額は、消費税等抜きで表示しております。
４．経常的な設備の更新のための除・売却を除き、重要な設備の除・売却の計画はありません。
５．全社（共通）は、当社の一般管理部門及び共通研究等のセグメント配賦不能な設備投資額であります。
６．各セグメントの計画概要は次のとおりであります。
ソフトウェア・サービス関係につきましては、アウトソーシング設備関連投資を中心に、当社単独で40,000百万円、連結子会社で40,000百万円であります。
プラットフォーム関係につきましては、モバイルシステム、ＩＰシステム、サーバ開発設備関連投資を中心に、当社単独で25,000百万円、連結子会社で25,000百万円であります。
電子デバイス関係につきましては、最先端ロジックＩＣ開発・量産設備を中心に、単独で30,000百万円、連結子会社で35,000百万円であります。

(2) 重要な設備の新設の計画は、次のとおりであります。
ソフトウェア・サービス

事業所名		所在地	設備の内容	投資予定金額（百万円）	着手及び完了予定	
					着手	完了
提出会社	ソフトウェア・サービス事業新拠点	東京都大田区	システム開発設備	30,000	平成14年６月	平成15年10月